

**디에이치케이솔루션㈜**

당사는 반도체 공정 장비 중 Grinding / Sawing 장비 세계 시장 점유율 70%이상을 차지하고 있는

日 DISCO社와의 합작법인으로서, 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 Big 2 및 유수의 반도체

회사를 고객으로 하여 DISCO社 장비를 독점 공급하고 있는 Total Solution Provider입니다.

저희 디에이치케이솔루션㈜에서 고객사 대응 최전선에서 반도체 시장의 미래를 함께 꿈꿔 나갈

장비 엔지니어를 공개 모집하고자 합니다.

**■ 모집 부문**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **부문** | **지원자격 및 우대사항** | **담당 직무** | **근무지** |
| 반도체장비엔지니어 | <지원자격>- 졸업자 또는 졸업예정자로, 전공무관<우대사항>- 공학 계열 우대- 운전가능자, 일본어 회화 가능자 우대- 해외여행에 결격 사유가 없는 자 | 반도체 장비 Set-up 및 Maintenance | 동탄 아산 |

※ 보훈대상자 및 장애인 복지법상 장애인은 관계법령에 의거 우대합니다.

**■ 근무 조건**

1) 근무시간 : 09:00 ~ 18:00 (점심 및 휴게시간 1시간), 주 5일 근무

1. 급여수준 : 대졸 신입사원 기준 3,800만원/년 이상 (각종 수당 및 성과급 별도 지급)

 정규 근로시간 外 근로 시 법정초과근로수당 별도 지급

1. 복리후생 : 통신비, 교통비, 경조사 지원, 해외 연수 기회 부여 등

**■ 원서 접수**

1) 지원방법 : 채용담당(recruit@dhk.co.kr) 메일로 제출

2) 접수기간 : ’~ 1.12(일)

**■ 제출 서류**

- 입사지원서 및 자기소개서 (디에이치케이솔루션㈜ 지정 양식 사용)

**■ 전형 절차**

- 서류전형(결과 개별 통보) → 1차면접 → 2차면접 → 입사

**■ 유의사항**

- 추후 지원하신 내용이 사실과 다를 경우, 채용이 취소될 수 있습니다.